

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零一七年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2018年2月8日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一七年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一七年第四季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入持續刷新記錄，達2.169億美元，再次實現歷史新高，環比增長3.3%，同比增長11.8%。
- 毛利率33.7%，環比下降1.5個百分點，同比上升2.7個百分點。
- 期內溢利上升到4,150萬美元，環比增長17.4%，同比增長8.7%。
- 每股盈利0.04美元，環比上升0.01美元，同比持平。
- 淨資產收益率（年化）10.0%，環比上升1.2個百分點。

二零一七年度（未經審核）

- 銷售收入8.081億美元，較上年度大幅增長12.0%。
- 毛利率33.1%，較上年度上升2.6個百分點。
- 年內溢利1.453億美元，較上年度上升12.8%。
- 每股盈利0.14美元，較上年度上升0.02美元。
- 淨資產收益率9.1%，較上年度上升0.5個百分點。

二零一八年第一季度指引

- 我們預計銷售收入在 2.09 億美元與 2.10 億美元之間，較本季度略有下降，主要由於受季節性因素和兩間工廠年度維護的影響。銷售收入同比預計將增長 14%到 15%。
- 我們預計毛利率約為 30%。

二零一七年度股利派發

- 公司將會在二零一八年五月召開的周年大會上，根據已公佈的股利政策（連續三年所派股息的平均額不低於該三年平均可分配淨利潤的 30%），決定二零一七會計年度股利分配方案。

本公司總裁兼執行董事王煜先生，對業績評論道：

“華虹半導體二零一七年強勁收官。第四季度的業績表現毋庸置疑是極其傑出的！全年銷售收入 8.081 億美元，所銷售產品幾乎涵蓋了所有相關領域，尤其是銀行卡、身份證、超級結、IGBT 和電源管理器芯片。得益於所有客戶的參與和全體員工的奉獻，公司的毛利率和淨利潤率均大幅超越 2016 年度。這再一次證明了公司戰略的成功，並展示了我們對業務成長和盈利能力的不懈追求。”

“如之前的業績公告中所提及，客戶對公司 200mm 晶圓需求持續強勁，已遠超我們的產能，因此需要大規模的擴產。新建一座 300mm 晶圓廠能最好地滿足這一需求。此外，部分現有客戶的需求僅能通過 300mm 的技術才能滿足，對 300mm 晶圓產能有巨大需求的潛在新客戶亦已蓄勢待發。鑒於這些原因，我們將同國家集成電路產業投資基金和無錫市政府一起，在無錫合資興建一座 300mm 晶圓廠。”

“我們相信，用 300mm 的產能來擴展我們 200mm 的業務是接下來最好的選擇”，王煜先生繼續說道，“如此，我們既可以獲得所需的產能，又能將工藝技術能力提升至 65nm。我們已在 90nm 技術平臺成功量產，這為我們在 300mm 晶圓上生產 90nm 和接下來的 65nm 產品奠定了基礎，因此，300mm 業務是我們現有經驗的自然延伸。列舉一些我們非常成功的技術，如嵌入式非易失性存儲器、射頻、電源管理晶片及相關的 IP，都可以快速轉移並導入到 300mm 設備上。”

“總之”，王煜先生總結說，“無錫項目將為公司提供急需的產能和技術，以滿足客戶全方位的需求，從而解決我們在可預見未來面對的產能瓶頸問題！此外，同樣重要的是，無錫項目也將顯著擴大我們的客戶群。”

電話會議公告

日期： 二零一八年二月九日

時間： 下午 04:00 (上海 / 香港)
上午 03:00 (紐約, 2018 年 2 月 9 日)

發言人： 王煜，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：

http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 或

https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~2017_q4_earnings_call

電話詳細：	國際	+65 6713 5521
	中國	+86 800 870 0531/+86 400 624 0406
	香港	+852 3018 6768
	臺灣	+886 277 031 751
	紐約	+1 347 549 4095

電話會議登入名： 2727809

密碼： HUAHONG

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）是全球領先的特色工藝晶圓製造企業，專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等差異化工藝平臺，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。華虹半導體是華虹集團的一員，而華虹集團是國家“909”工程的載體，是以集成電路製造為主業、面向全球市場、具有自主創新能力和市場競爭力的高科技產業集團。

華虹半導體在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠、三廠），月產能約 17 萬片；擬在無錫高新技術產業開發區內新建一條月產能 4 萬片的 12 英寸集成電路生產線（華虹七廠）。

如需查詢詳細資訊，請登陸華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	環比	同比
銷售收入	216,916	209,928	194,026	3.3 %	11.8 %
銷售成本	(143,809)	(135,960)	(133,946)	5.8 %	7.4 %
毛利	73,107	73,968	60,080	(1.2)%	21.7 %
毛利率	33.7 %	35.2 %	31.0 %	(1.5)	2.7
經營開支	(36,773)	(29,336)	(29,727)	25.4 %	23.7 %
其他收入淨額	12,200	4,438	14,440	174.9 %	(15.5)%
稅前溢利	48,534	49,070	44,793	(1.1)%	8.4 %
所得稅開支	(7,032)	(13,729)	(6,597)	(48.8)%	6.6 %
期內溢利	41,502	35,341	38,196	17.4 %	8.7 %
淨利潤率	19.1 %	16.8%	19.7 %	2.3	(0.6)
每股盈利					
基本	0.04	0.03	0.04	33.3 %	-
攤薄	0.04	0.03	0.04	33.3 %	-
付運晶圓(仟片)	501	477	488	5.0 %	2.7 %
產能利用率 ¹	96.8 %	99.8 %	99.5 %	(3.0)	(2.7)
淨資產收益率 ²	10.0 %	8.8 %	10.4 %	1.2	(0.4)

二零一七年第四季度

- 銷售收入 2.169 億美元，環比增長 3.3%，同比增長 11.8%。
- 銷售成本 1.438 億美元，環比上升 5.8%，主要由於晶圓銷售量上升所致，同比上升 7.4%，主要由於晶圓銷售量上升及折舊成本增加所致。
- 毛利率 33.7%，環比下降 1.5 個百分點，主要由於計提年終獎金所致，同比上升 2.7 個百分點，主要得益於平均銷售價格提升及產品組合優化，部分被折舊成本增加所抵消。
- 經營開支 3,680 萬美元，環比上升 25.4%，主要由於(i)計提年終獎金，及(ii)計提設備減值準備所致，同比上升 23.7%，主要由於人工費用和研發開支增加，及人民幣升值所帶來的匯率折算的影響所致。
- 其他收入淨額 1,220 萬美元，環比增加 174.9%，主要得益於分估一家聯營公司盈利增加，同比減少 15.5%，主要由於本季度發生匯兌損失，部分被分估一家聯營公司盈利增加所抵消。
- 所得稅開支 700 萬美元，環比下降 48.8%，主要由於納稅扣除項的年終調整。
- 期內溢利 4,150 萬美元，環比上升 17.4%，同比上升 8.7%。
- 淨利潤率 19.1%，環比上升 2.3 個百分點，同比下降 0.6 個百分點。
- 每股盈利 0.04 美元，環比上升 0.01 美元，同比持平。
- 淨資產收益率（年化）10.0%，環比上升 1.2 個百分點。

¹產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

²季度淨資產收益率按年計算。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (已經審核)	同比
銷售收入	808,148	721,428	12.0 %
銷售成本	(540,971)	(501,080)	8.0 %
毛利	267,177	220,348	21.3 %
毛利率	33.1 %	30.5 %	2.6
經營開支	(115,905)	(104,218)	11.2 %
其他收入淨額	21,215	37,350	(43.2)%
稅前溢利	172,487	153,480	12.4 %
所得稅開支	(27,225)	(24,648)	10.5 %
年內溢利	145,262	128,832	12.8 %
淨利潤率	18.0%	17.9 %	0.1
每股盈利			
基本	0.14	0.12	16.7 %
攤薄	0.14	0.12	16.7 %
付運晶圓(仟片)	1,869	1,787	4.6 %
產能利用率	98.1 %	97.6 %	0.5
淨資產收益率	9.1 %	8.6 %	0.5

二零一七年度

- 銷售收入達 8.081 億美元，較上年度增長 12.0%。
- 毛利率 33.1%，較上年度上升 2.6 個百分點，主要得益於平均銷售價格提升及產品組合優化，部分被折舊成本增加所抵消。
- 經營開支 1.159 億美元，較上年度上升 11.2%，主要由於人工費用和研發開支增加，及人民幣升值所帶來的匯率折算的影響所致。
- 其他收入淨額 2,120 萬美元，較上年度下降 43.2%，主要由於本年度發生匯兌損失，上年度為匯兌收益。
- 所得稅開支 2,720 萬美元，較上年度上升 10.5%，主要由於應稅利潤增加。
- 年內溢利達 1.453 億美元，較上年度上升 12.8%。
- 每股盈利 0.14 美元，較上年度上升 0.02 美元。
- 淨資產收益率 9.1%，較上年度上升 0.5 個百分點。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
晶圓	212,552	98.0 %	204,516	97.4 %	8,036	3.9 %
其他	4,364	2.0 %	5,412	2.6 %	(1,048)	(19.4)%
銷售收入總額	216,916	100.0 %	209,928	100.0 %	6,988	3.3 %

- 本季度 98.0% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
中國 ³	122,410	56.3 %	116,530	55.6 %	5,880	5.0 %
美國	41,133	19.0 %	37,887	18.0 %	3,246	8.6 %
亞洲 ⁴	22,246	10.3 %	26,281	12.5 %	(4,035)	(15.4)%
歐洲	15,581	7.2 %	14,573	6.9 %	1,008	6.9 %
日本 ⁵	15,546	7.2 %	14,657	7.0 %	889	6.1 %
銷售收入總額	216,916	100.0 %	209,928	100.0 %	6,988	3.3 %

- 本季度來自中國的銷售收入 1.224 億美元，占銷售收入總額的 56.3%，環比增長 5.0%，主要得益於智能卡芯片的需求增加。
- 本季度來自美國的銷售收入 4,110 萬美元，環比增長 8.6%，主要得益於 MCU 和超級結產品的需求增加，部分被邏輯產品的需求減少所抵消。
- 本季度來自亞洲的銷售收入 2,220 萬美元，環比減少 15.4%，主要由於邏輯和通用 MOSFET 產品的需求減少所致。
- 本季度來自歐洲的銷售收入 1,560 萬美元，環比增加 6.9%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度來自日本的銷售收入 1,550 萬美元，環比增加 6.1%，主要得益於 MCU、閃存、超級結和其他電源管理產品的需求增加，部分被邏輯產品的需求減少所抵消。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的 銷售收入	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
嵌入式非易失性存儲器	85,940	39.6 %	75,832	36.1 %	10,108	13.3 %
分立器件	62,319	28.7 %	57,872	27.6 %	4,447	7.7 %
模擬與電源管理	40,572	18.7 %	39,761	18.9 %	811	2.0 %
邏輯及射頻	19,200	8.9 %	28,471	13.6 %	(9,271)	(32.6)%
獨立非易失性存儲器	8,327	3.8 %	7,600	3.6 %	727	9.6 %
其他	558	0.3 %	392	0.2 %	166	42.3 %
銷售收入總額	216,916	100.0 %	209,928	100.0 %	6,988	3.3 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 8,590 萬美元，環比增加 13.3%，主要得益於智能卡芯片和 MCU 產品的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 6,230 萬美元，環比增長 7.7%，主要得益於超級結和通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 4,060 萬美元，環比增長 2.0%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度邏輯和射頻銷售收入 1,920 萬美元，環比減少 32.6%，主要由於邏輯產品的需求減少所致。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 830 萬美元，環比增長 9.6%，主要得益於閃存產品需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點 劃分的銷售收入	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
0.13μm 及以下	76,054	35.1 %	69,559	33.1 %	6,495	9.3 %
0.15μm 及 0.18μm	33,187	15.3 %	39,462	18.8 %	(6,275)	(15.9)%
0.25μm	4,769	2.2 %	3,744	1.8 %	1,025	27.4 %
0.35μm 及以上	102,906	47.4 %	97,163	46.3 %	5,743	5.9 %
銷售收入總額	216,916	100.0 %	209,928	100.0 %	6,988	3.3 %

- 本季度 0.13μm 及以下工藝技術節點的銷售收入 7,610 萬美元，環比增長 9.3%，主要得益於智能卡芯片的需求增加。
- 0.15μm 及 0.18μm 工藝技術節點的銷售收入 3,320 萬美元，環比減少 15.9%，主要由於邏輯、MCU 和智能卡芯片的需求減少所致。
- 本季度 0.25μm 工藝技術節點的銷售收入 480 萬美元，環比增加 27.4%，主要得益於通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度 0.35μm 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.029 億美元，環比增長 5.9%，主要得益於超級結、其他電源管理和 MCU 產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一七年 第四季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第四季度 % (未經審核)	二零一七年 第三季度 仟美元 (未經審核)	二零一七年 第三季度 % (未經審核)	環比 仟美元	環比 %
電子消費品	151,242	69.7 %	144,402	68.8 %	6,840	4.7 %
工業及汽車	28,115	13.0 %	28,879	13.8 %	(764)	(2.6)%
通訊	27,358	12.6 %	26,089	12.4 %	1,269	4.9 %
計算機	10,201	4.7 %	10,558	5.0 %	(357)	(3.4)%
銷售收入總額	216,916	100.0 %	209,928	100.0 %	6,988	3.3 %

- 本季度電子消費品仍然是我們第一大終端市場，貢獻銷售收入 1.512 億美元，占銷售收入總額的 69.7%，環比增長 4.7%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 2,810 萬美元，環比減少 2.6%，主要由於 MCU 產品需求的減少，部分被超級結產品的需求增加所抵消。
- 本季度通訊產品銷售收入 2,740 萬美元，環比增加 4.9%，主要得益於智能卡芯片的需求增加。

產能⁶及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	63	63	56
2 號晶圓廠	57	57	57
3 號晶圓廠	48	46	42
合計	168	166	155
產能利用率	96.8%	99.8%	99.5%

- 隨著 3 號晶圓廠的擴產釋放產能，本季度末總產能增至每月 168 仟片。本季度產能利用率仍保持在較高水平，得益於客戶強勁的訂單需求。

⁶ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

仟片晶圓	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	環比	同比
付運晶圓	501	477	488	5.0 %	2.7 %

- 本季度付運晶圓 501 仟片，環比增加 5.0%，主要由於客戶需求增加。

經營開支分析

以千美元計	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	環比	同比
銷售及分銷費用	2,153	1,826	2,003	17.9 %	7.5 %
管理費用 ⁷	34,620	27,510	27,724	25.8 %	24.9 %
經營開支	36,773	29,336	29,727	25.4 %	23.7 %

- 經營開支 3,680 萬美元，環比上升 25.4%，主要由於(i)計提年終獎金，及(ii)計提設備減值準備所致，同比上升 23.7%，主要由於人工費用和研發開支增加，及人民幣升值所帶來的匯率折算的影響所致。

其他收入淨額分析

以千美元計	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	環比	同比
租金收入	3,362	3,607	3,772	(6.8)%	(10.9)%
利息收入	2,042	1,819	1,367	12.3 %	49.4 %
匯兌(損失)/收益	(2,992)	(3,235)	6,024	(7.5)%	(149.7)%
分佔一家聯營公司溢利	8,515	1,248	3,871	582.3 %	120.0 %
財務費用	(572)	(557)	(874)	2.7 %	(34.6)%
政府補貼	2,519	1,429	320	76.3 %	687.2 %
其他	(674)	127	(40)	(630.7)%	1,585.0 %
其他收入淨額	12,200	4,438	14,440	174.9 %	(15.5)%

- 其他收入淨額 1,220 萬美元，環比增加 174.9%，主要得益於分佔一家聯營公司盈利增加，同比減少 15.5%，主要由於本季度發生匯兌損失，部分被分佔一家聯營公司盈利增加所抵消。

⁷管理費用包括確認為研發開支抵銷項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)	二零一六年 第四季度 (未經審核)	環比	同比
經營活動所得現金流量淨額	88,282	75,394	84,319	17.1 %	4.7 %
投資活動所得/(用)現金流量淨額	38,653	(76,675)	(23,060)	(150.4)%	(267.6)%
融資活動所得/(用)現金流量淨額	208	(556)	(86,424)	(137.4)%	(100.2)%
外匯匯率變動影響淨額	3,894	4,253	(8,766)	(8.4)%	(144.4)%
現金及現金等價物變動影響淨額	131,037	2,416	(33,931)	5,323.7 %	(486.2)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 8,830 萬美元，環比上升 17.1%，主要得益於收到的政府補貼增加及支付的薪資及動力費減少。
- 本季度投資活動所得現金流量淨額 3,870 萬美元，其中包括(i)收回定期存款投資 5,460 萬美元，及(ii)收到利息收入 180 萬美元，部分被設備投資支出 1,780 萬美元所抵消。
- 本季度融資活動所得現金流量淨額 20 萬美元，其中包括因股票期權行權而增發股份收到的投資款 280 萬美元，大部分被(i)償還銀行貸款本金 200 萬美元及(ii) 支付利息 60 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於十二月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)
資產總額	2,078,306	1,989,929
負債總額	383,101	365,559
所有者權益總額	1,695,205	1,624,370
資產負債率 ⁸	18.4%	18.4%

資本開支

以千美元計	二零一七年 第四季度 (未經審核)	二零一七年 第三季度 (未經審核)
資本開支	17,780	33,757

- 本季度資本開支 1,780 萬美元，上季度為 3,380 萬美元。

⁸ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於十二月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)
存貨	115,578	115,500
貿易應收款項及應收票據	112,372	110,624
預付款項、按金及其他應收款項	10,074	12,943
應收關聯方款項	46,988	46,217
已凍結存款及定期存款	193,530	246,931
現金及現金等價物	374,890	243,853
流動資產總額	853,432	776,068
貿易應付款項	68,124	66,978
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	129,908	114,707
計息銀行借款	60,751	4,219
政府補助	40,523	41,572
應付關聯方款項	10,885	14,264
應付所得稅	26,648	23,806
流動負債總額	336,839	265,546
淨營運資金	516,593	510,522
速動比率	2.2x	2.5x
流動比率	2.5x	2.9x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	52	51
存貨周轉天數	72	72

- 預付款項、按金及其他應收款項由上季度末的 1,290 萬美元下降至本季度末的 1,010 萬美元，主要由於對供應商的預付款減少所致。
- 已凍結存款及定期存款由上季度末的 2.469 億美元下降至本季度末的 1.935 億美元，主要由於收回定期存款投資 5,460 萬美元所致。
- 其他應付款項、預收賬款及暫估費用由上季度末的 1.147 億美元上升至本季度末的 1.299 億美元，主要由於計提年終獎金所致。
- 計息銀行借款由上季度末的 420 萬美元上升至本季度末的 6,080 萬美元，主要由於重分類一年內到期的借款所致。
- 應付關聯方款項由上季度末的 1,430 萬美元下降至本季度末的 1,090 萬美元，主要由於確認了本季度的關聯方房屋租金所致。
- 應付所得稅由上季度末的 2,380 萬美元上升至本季度末的 2,660 萬美元，主要由於計提本季度所得稅開支所致。
- 本季度末淨營運資金 5.166 億美元，流動比率 2.5。
- 本季度貿易應收款項及應收票據周轉天數 52 天。
- 本季度存貨周轉天數為 72 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)
銷售收入	216,916	209,928	194,026
銷售成本	(143,809)	(135,960)	(133,946)
毛利	73,107	73,968	60,080
其他收入及收益	7,160	7,049	12,034
投資物業的公平值收益	89	-	72
銷售及分銷費用	(2,153)	(1,826)	(2,003)
管理費用	(34,620)	(27,510)	(27,724)
其他費用	(2,992)	(3,302)	(663)
財務費用	(572)	(557)	(874)
分佔一家聯營公司溢利	8,515	1,248	3,871
稅前溢利	48,534	49,070	44,793
所得稅開支	(7,032)	(13,729)	(6,597)
期內溢利	41,502	35,341	38,196
以下各方應佔利潤:			
母公司擁有人	41,502	35,341	38,196
非控股權益	-	-	-
持有人應佔每股盈利			
基本	0.04	0.03	0.04
攤薄	0.04	0.03	0.04
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,036,020,104	1,034,043,768	1,033,871,656
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,047,910,104	1,043,395,768	1,040,365,656

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計, 每股盈利和股數除外)

	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (已經審核)
銷售收入	808,148	721,428
銷售成本	(540,971)	(501,080)
毛利	267,177	220,348
其他收入及收益	24,394	34,761
投資物業的公平值收益	89	72
銷售及分銷費用	(7,232)	(6,814)
管理費用	(108,673)	(97,404)
其他費用	(10,712)	(666)
財務費用	(2,178)	(3,873)
分佔一家聯營公司溢利	9,622	7,056
稅前溢利	172,487	153,480
所得稅開支	(27,225)	(24,648)
期內溢利	145,262	128,832
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	145,262	128,832
非控股權益	-	-
持有人應佔每股盈利		
基本	0.14	0.12
攤薄	0.14	0.12
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,034,430,282	1,033,871,656
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,043,366,282	1,037,288,656

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於十二月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一六年 (已經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	733,462	737,713	656,517
投資物業	179,586	176,718	169,074
預付土地租賃款項	20,634	20,481	20,071
無形資產	7,411	8,002	8,176
於聯營公司的投資	57,577	48,258	45,121
可供出售投資	215,864	212,524	203,330
長期預付款項	3,266	2,801	3,861
遞延稅項資產	7,074	7,364	5,720
非流動資產總額	1,224,874	1,213,861	1,111,870
流動資產			
存貨	115,578	115,500	95,199
貿易應收款項及應收票據	112,372	110,624	106,078
預付款項、按金及其他應收款項	10,074	12,943	8,963
應收關聯方款項	46,988	46,217	37,752
已凍結存款及定期存款	193,530	246,931	125,547
現金及現金等價物	374,890	243,853	341,255
流動資產總額	853,432	776,068	714,794
流動負債			
貿易應付款項	68,124	66,978	64,790
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	129,908	114,707	101,507
計息銀行借款	60,751	4,219	1,874
政府補助	40,523	41,572	35,863
應付關聯方款項	10,885	14,264	9,689
應付所得稅	26,648	23,806	24,222
流動負債總額	336,839	265,546	237,945
流動資產淨額	516,593	510,522	476,849
總資產減流動負債	1,741,467	1,724,383	1,588,719
非流動負債			
計息銀行借款	32,139	90,061	90,757
遞延稅項負債	14,123	9,952	9,276
非流動負債總額	46,262	100,013	100,033
淨資產	1,695,205	1,624,370	1,488,686
權益和負債權益			
股本	1,554,870	1,550,820	1,550,164
儲備	140,335	73,550	(61,478)
權益總額	1,695,205	1,624,370	1,488,686

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於十二月三十一日 二零一七年 (未經審核)	於九月三十日 二零一七年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零一六年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	48,534	49,070	44,793
折舊及攤銷	28,217	27,717	23,512
應佔聯營公司溢利	(8,515)	(1,248)	(3,871)
營運資金的變動及其它	20,046	(145)	19,885
經營活動所得現金流量淨額	88,282	75,394	84,319
投資活動所得/(用)現金流量：			
購買物業、廠房及設備項目	(17,780)	(33,757)	(24,243)
其他投資活動所用的現金流量	56,433	(42,918)	1,183
投資活動所得/(用)現金流量	38,653	(76,675)	(23,060)
融資活動所得/(用)現金流量：			
發行股份所得收益	2,759	-	-
償還銀行貸款	(1,990)	-	(85,500)
已付利息	(561)	(556)	(924)
融資活動所得/(用)現金流量	208	(556)	(86,424)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	127,143	(1,837)	(25,165)
外匯匯率變動影響淨額	3,894	4,253	(8,766)
期初現金及現金等價物	243,853	241,437	375,186
期末現金及現金等價物	374,890	243,853	341,255

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (已經審核)
經營活動所得現金流量：		
稅前溢利	172,487	153,480
折舊及攤銷	104,628	85,078
應佔聯營公司溢利	(9,622)	(7,056)
營運資金的變動及其它	(9,193)	(19,594)
經營活動所得現金流量淨額	258,300	211,908
投資活動所用現金流量：		
購買物業、廠房及設備項目	(135,808)	(172,636)
其他投資活動所用的現金流量	(61,195)	(60,762)
投資活動所用現金流量	(197,003)	(233,398)
融資活動所用現金流量：		
發行股份所得收益	2,759	-
向股東支付股息	(39,693)	(35,922)
已凍結存款的增加	(5)	(8)
償還銀行貸款	(1,990)	(85,500)
已付利息	(2,167)	(3,911)
融資活動所用現金流量淨額	(41,096)	(125,341)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	20,201	(146,831)
外匯匯率變動影響淨額	13,434	(22,355)
期初現金及現金等價物	341,255	510,441
期末現金及現金等價物	374,890	341,255

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波

馬玉川

森田隆之

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壩太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零一八年二月八日